

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 10/06/2020 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 58

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 26, DE 4 DE JUNHO DE 2020

Altera o Processo Produtivo Básico de PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADAS, industrializadas no País.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E COMPETITIVIDADE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria ME nº 213, de 14 de maio de 2020 (publicada no DOU de 15.05.2020, Seção 1, pág. 15), e o SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria MCTIC nº 5.071, de 24 de setembro de 2019 (publicada no DOU de 25.09.2019, Seção 1, pág. 15), tendo em vista o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1º do art. 2º e nos arts. 16 a 19 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo nº 19687.102563/2020-40 do Ministério da Economia, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para os produtos PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADAS, produzidas no País, estabelecido pela Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC nº 26, de 26 de junho de 2019, passa a ser o seguinte:

I - montagem e soldagem, ou processo equivalente, de todos os componentes nas placas de circuito impresso; e

II - configuração, gravação de programas de computador, quando aplicável, e teste.

§ 1º Para o cumprimento do disposto neste artigo, fica temporariamente dispensado da montagem os seguintes subconjuntos ou módulos:

I - Microprocessador montado em placa com barramento de conexão à placa-mãe com mais de duzentas vias, acondicionado ou não em cartucho;

II - Módulo SOM (System on Module) com circuito lógico e/ou de rádio frequência integrado próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície - SMT (Surface Mounted Technology); e

III - Módulo de comunicação Bluetooth próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície - SMT (Surface Mounted Technology).

§2º Este Processo Produtivo Básico não se aplica às placas de circuito impresso montadas com a função de memória ou MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS.

§ 3º Serão válidas para cumprimento deste Processo Produtivo Básico as etapas produtivas realizadas no País.

Art. 2º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Art. 3º Fica revogada a Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC nº 26, de 26 de junho de 2019.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALEXANDRE DA COSTA

Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO

Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações



Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

